

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-118

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。

#### 二、募集资金管理与使用情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司与保荐机构、相应开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2021-017、临2021-039、临2023-076）。

截至本公告披露日，公司开立的募集资金专项账户的情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	专户用途	当前状态
环旭电子股份有限公司	中国银行上海市南汇支行营业部	442981110010	盛夏厂芯片模组生产项目	项目于2023年8月结项，余额已转移至新账户，账户本次注销

	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902408810808	越南厂可穿戴设备生产项目	存续
	中国建设银行上海宝钢宝山支行	31050168360000007485	惠州厂电子产品生产项目	项目结项，除未结息金额外，其余余额已转移至新账户，账户待注销
	富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300003130014699	补充流动资金项目	余额已补充流动资金，项目结项，账户本次注销
	交通银行上海新区支行	310066111013007546476	“墨西哥厂新建第二工厂项目”的项目建设及归还借款	存续
环荣电子(惠州)有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	632648187	惠州厂电子产品生产项目	项目结项，余额已转移至新账户，账户本次注销
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED	BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH	100000600381093	越南厂可穿戴设备生产项目	存续

### 三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

截至本公告披露日，结项募集资金投资项目的募集资金具体使用及结余情况

如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资金额	调整后募集资金拟投资额	实际累计投资金额	利息及理财收益净额	募集资金节余金额(含利息)
盛夏厂芯片模组生产项目	86,000.00	/	79,283.01	2,080.85	8,797.84
惠州厂电子产品生产项目	100,000.00	70,000.00	69,926.48	4,669.07 <sup>注1</sup>	4,742.59
补充流动资金项目	100,957.00 <sup>注2</sup>	/	100,957.00	80.47	80.47

注 1：本金额系截至 2023 年 11 月 29 日数据，具体金额以募集资金专户注销当天实际结息金额为准；

注 2：本金额系扣除本次发行费用人民币 19,273,584.91 元及对应增值税人民币 1,156,415.09 元后的净额。

本次募集资金节余主要系募集资金产生的利息及理财收入。

(一) 盛夏厂芯片模组生产项目和惠州厂电子产品生产项目

根据公司 2023 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和债券持有人会议决议，公司将盛夏厂芯片模组生产项目全部节余募集资金(含利息)人

人民币 8,797.84 万元，惠州厂电子产品生产项目调减募集资金投资规模人民币 30,000.00 万元和节余的募集资金（含利息）4,742.59 万元，合计人民币 43,540.43 万元（截至 2023 年 11 月 29 日数据，具体金额以募集资金专户注销当天实际结息金额为准），全部用于向墨西哥厂增资 6,000 万美元（或等值人民币，具体金额以实际换汇金额计算，差额部分以自有资金补足），增资资金将用于“墨西哥厂新建第二工厂项目”的项目建设及归还借款，由墨西哥厂负责实施。截至公告日，盛夏厂芯片模组生产项目专户的余额已转入“墨西哥厂新建第二工厂项目”项目建设及归还借款的专户，其对应的募集资金专户已完成注销；惠州厂电子产品生产项目专户的余额已转入“墨西哥厂新建第二工厂项目”项目建设及归还借款的专户，其对应的募集资金专户中国民生银行股份有限公司深圳分行账户已完成注销，由于银行结息要求，中国建设银行上海宝钢宝山支行账户本次尚未注销，待注销后另行披露。

## （二）补充流动资金项目

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，公司使用节余募集资金（包括利息收入）可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、保荐人、监事会发表意见。鉴于公司补充流动资金项目募集资金已使用 100%，专户余额为募集资金产生的利息，小于 100 万元，本项目结项。截至本公告披露日，该项目对应的募集资金专户余额已全部转出，该账户已完成注销。

截至公告日，公司已办理完毕上述项目三个募集资金专户的注销手续，已注销募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止；惠州厂电子产品生产项目已结项，募集资金专户中国建设银行上海宝钢宝山支行账户待注销后另行披露。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日